

2月市场洞察报告

半导体市场分析与趋势展望

洞察行情 精准决策

“DISTINCTIVE
INSIGHTS,
INFORMED
DECISION-MAKING”

序言

本报告由安芯易电子商务（深圳）有限公司推出，旨在为客户、供应商及合作伙伴提供半导体行业资讯及市场趋势预测，报告涵盖宏观动态、半导体产业动态、终端市场动态、重点产品行情等模块，助力行情洞察、精准决策。

本报告每月更新，可关注安芯易电子微信公众号，及时获取报告发布等信息。您也可以通过联系安芯易客户经理获取完整版报告。

目录

摘要 4

一、宏观动态 6

 (一) 行业政策 6

 (二) 经济指数 7

二、半导体产业动态 12

 (一) 短期影响 13

 (二) 中期影响 16

 (三) 长期影响 18

三、终端市场动态 20

 (一) 人工智能 22

 (二) 机器人 23

 (三) 汽车 25

 (四) 工业 27

 (五) 医疗 27

四、重点产品行情 29

 (一) 存储芯片 29

 (二) CPU 30

 (三) 存储设备 31

信息来源 33

免责声明 41

摘要

2026 年 2 月重点行情趋势	
宏观动态	● 中东：地缘冲突升级，半导体供应链面临多重冲击 ● 美国：拟扩大政府采购芯片禁令，SIA 公开反对 ● 欧盟：聚焦尖端制程，落地《芯片法案》核心设施 ● 日本：开出“半价建厂”条件，但遭韩国巨头谨慎观望 ● 中国：精准实施对日出口管制，狙击半导体供应链上游
产业动态	短期影响 ● 意法半导体：与 AWS 签署数十亿美元战略合作 ● 英飞凌：4 月启动功率器件涨价，完成 ams OSRAM 传感器业务收购，双轮驱动锁定 AI 与汽车赛道 ● 南亚科技：Q4 营收季增 54.7%，营业利润率跃升至 39.1% ● 亚德诺：Q1 营收 31.6 亿美元超预期，连续 22 年上调股息 ● 三星电子/SK 海力士：二季度 DRAM 价格涨幅最高达 100%，卖方市场格局确立 ● 士兰微/新洁能/宏微科技/华润微：国产功率半导体厂商 2-3 月集体上调产品价格，涨幅普遍在 10%左右 ● 国巨/基美：4 月 1 日起上调 T523 系列钽电容价格，系 9 个月内第三次涨价 中期影响 ● 瑞萨电子：任命刘芳出任中国区总裁，并与格罗方德达成数十亿美元战略合作 ● SK 海力士：追加 150 亿美元投资龙仁晶圆厂，HBM 产能提前释放 ● 台积电：中国台湾地区十座晶圆厂同步推进，2nm 量产加速、CoWoS 产能年底达 14 万片 ● 德州仪器：以 75 亿美元现金收购芯科科技，强化无线连接业务 ● 力积电：与美光达成战略合作，出售铜锣厂并切入 HBM 供应链 长期影响： ● 英伟达：Q4 营收 681 亿美元同比增 73%，黄仁勋称“代理式 AI 拐点已至” ● 超威半导体：Meta 与 AMD 达成 600 亿美元 AI 芯片采购协议 ● 三星电子：Q4 DRAM 营收 193 亿美元，季增 43%重返第一 ● 美光：宣布 2000 亿美元美国本土扩产计划，HBM4 已量产提前出货
终端市场	人工智能 ● 亚马逊与 OpenAI 达成 1000 亿美元战略联盟，部署 2GW Trainium 计算能力 ● 微软将 Maia 200 AI 加速器商业化，为 GPT-5.2 和 Copilot 服务提供支持 ● 华为在 2026 年世界移动通信大会（MWC 2026）上发布 Atlas 950 SuperPoD，提供 8192 节点统一集群 ● 寒武纪科技 2025 年营收同比增长 453%，实现全年盈利，人工智能蓬勃发展

	机器人 ● 特斯拉以 Optimus 生产线取代 Model S/X 生产线，助力实现百万级年产量 ● 春节联欢发布会后，Unitree G1 订单激增 ● Agibot 进军德国市场，并与 Minth 集团合作进行工业部署 汽车 ● 比亚迪将于 3 月 5 日举办“惊悚”技术发布会，推出下一代平台 ● 特斯拉 FSD 订阅：硬件优先模式 ● 小米汽车慕尼黑研发中心助力其全球扩张，年产量有望达到 55 万辆 ● 小鹏汽车发布搭载 2250 TOPS 图灵芯片的第二代 VLA，助力 L4 级自动驾驶 工业 ● 富士康：通过休斯顿人工智能服务器扩展“物理人工智能” ● 西门子推出 Questa One 智能人工智能工具包，实现芯片验证自动化 医疗 ● 迈瑞在埃及设立研发基地，以实现智能影像和 ICU 解决方案的本地化 ● 飞利浦首席执行官强调“环境感知”是未来医疗研发的核心支柱 ● 美敦力通过 Hugo 系统商业化和 PFA 创新扩大机器人手术业务版图
产品行情	● 存储芯片产能告急，卖方市场格局已然确立 ● AI 算力需求爆发，带动 CPU 市场需求增长 ● 存储设备全面涨价严重缺货，消费市场供应受压

一、宏观动态

（一）行业政策

● 中东：地缘冲突升级，半导体供应链面临多重冲击

2月28日，中东地缘局势骤然升级，伊朗向以色列发射导弹以回应美以军事打击，以色列、伊朗等多国宣布关闭领空。此次冲突直接冲击全球关键运输通道霍尔木兹海峡，该海峡承载全球约五分之一石油运输量及卡塔尔近五分之一液化天然气供应。伊朗宣布禁止船只通过后，油轮航行陷入停滞，马士基等航运巨头宣布改道或暂停航线。

从半导体供应链视角看，此次冲突通过多重传导路径构成冲击。其一，氦气供应面临中断风险——卡塔尔供应全球约30%氦气，为液化天然气生产副产品，需经霍尔木兹海峡外运，氦气是芯片制造中营造超洁净环境、冷却设备的关键气体。其二，以色列本土芯片产能承压——英特尔已暂停投资250亿美元的以色列工厂扩张计划，高塔半导体作为全球第七大晶圆代工厂，其模拟芯片产能若中断将影响全球汽车及工业芯片供给。其三，物流受阻延长交付周期——红海航线改道好望角，运输保险成本上升，印度对海湾地区电子产品出口面临延迟风险。其四，稀土供应隐忧显现——据行业信息，美国半导体制造商依赖的钇、铈等稀土元素面临短缺，钇价自2025年11月以来累计上涨约60%，部分芯片制造商库存告急。

● 美国：拟扩大政府采购芯片禁令，SIA公开反对

3月3日，美国联邦采购规则委员会发布拟议规则，计划修订《联邦采购规则》，禁止行政机构采购可追溯至中芯国际、长江存储、长鑫存储等特定中国企业的半导体产品。针对“关键系统”，禁令延伸至采用上述芯片的整机产品。提案于2月17日发布，意见征集截止4月20日，拟于2027年12月生效。

美国半导体行业协会（SIA）总裁 John Neuffer 发表声明明确反对，称无法支持“一刀切式的强制性禁令机制”，警告仓促立法可能损害全球对美国半导体技术的信任，阻碍美国 AI 技术出口，削弱美国竞争力。SIA 表示愿与国会探讨更有效的风险应对途径。

● 欧盟：聚焦尖端制程，落地《芯片法案》核心设施

欧盟在落实《欧洲芯片法案》方面取得实质性进展。2月9日，欧盟委员会宣布在比利时微电子研究中心正式启动迄今为止规模最大的芯片法案试点生产线——NanoIC。该设施总投资达25亿欧元，其中欧盟直接拨款7亿欧元，并部署了最先进的极紫外光刻设备，专注于2纳米以下工艺的设计与制造，旨在填补欧洲在先进制程研发领域的空白。此外，爱尔兰政府于2月17日启动了国家半导体能力中心，专注于为本国初创企业及中小企业提供流片渠道、培训及融资支持，以完善欧盟在芯片创新生态链上的布局。

- **日本：开出“半价建厂”条件，但遭韩国巨头谨慎观望**

为重振本国半导体产业，日本政府向韩国存储芯片巨头抛出了极具诱惑力的橄榄枝。2月下旬，据多家外媒报道，日本政府向三星电子和SK海力士提供了“全套支持方案”，包括税收减免、基础设施补贴及供应链对接。据测算，在日建设和运营存储芯片厂的总拥有成本仅为韩国本土的一半。然而，尽管成本优势巨大，SK海力士仍正式否认了关于投资2万亿日元建厂的报道，三星亦未做出实质性投资决定。分析指出，此举主要受限于韩国国内的舆论压力及对核心技术外流的担忧。与之对比，台积电和美光已在日本获得巨额补贴并快速扩张，显示出日本在全球半导体版图重组中的战略优先级差异。

- **中国：精准实施对日出口管制，狙击半导体供应链上游**

中国在本月展现出运用出口管制工具维护国家安全与战略利益的强硬姿态。2月24日，中国商务部发布两份重磅公告，将40家日本实体列入管控名单。其中，三菱造船、川崎重工、富士通防卫等20家实体因“参与提升日本军事实力”被列入出口管制管控名单，禁止向其出口两用物项；斯巴鲁、TDK、住友重机械工业、日东电工等20家实体因“无法核实最终用户”被列入关注名单，对其出口实施更为严格的最终用户和用途审查。此次被列入“关注名单”的TDK（从事化合物半导体射频芯片、封装材料）、住友重机（离子注入机）、日东电工（半导体材料）等企业，精准覆盖了半导体设备与材料的核心环节。此举可视作1月6日中国加强对日两用物项出口管制后的具体执行落地，通过切断上游关键材料与设备供应，直接狙击日本半导体产业及军事工业的供应链安全。在实施严格出口管制的同时，地方政策也在精准发力。2月下旬，深圳市工信局印发《深圳市“人工智能+”先进制造业行动计划（2026-2027年）》，明确提出以AI芯片为突破口，面向新能源汽车及AI终端市场，支持14纳米及以下车规级高阶智驾AI芯片、智能座舱SoC芯片的国产替代。这一政策表明，中国半导体战略正从“重制造”向“重应用、建生态”转变，旨在以庞大的内需市场拉动国产芯片的规模化落地。

（二）经济指数

- **1月全球制造业PMI升至50.9，连续六个月扩张彰显复苏韧性**

2026年1月，全球制造业PMI升至50.9，较2025年12月上升0.5个百分点，连续第六个月运行于荣枯线（50）上方，显示全球制造业整体商业状况持续改善，且复苏动能有所增强。主要经济体中，美国制造业PMI升至52.4，新订单指数达57.1，为近三年来最高水平，反映制造业需求明显回升；日本PMI升至51.5，为近三年半以来最高水平，制造业产出和新订单均显著增长；韩国PMI升至51.2，制造业扩张速度为近17个月以来较高水平；印度PMI维持在55.4高位，继续保持全球主要经济体中最强劲增长；中国PMI录得50.3，连续处于扩张区间，显示制造业活动保持

稳定恢复；欧元区 PMI 为 49.5，虽仍处收缩区间，但已明显接近荣枯线，制造业活动呈现企稳迹象。整体来看，全球制造业产出增速达到 2024 年中以来最快水平，新订单增长创近一年新高，出口订单降幅明显收窄，反映国际贸易流动趋于稳定，全球制造业复苏基础逐步巩固。同时，制造业投入成本与产品售价指数分别升至约三年来最高水平，供应商交付周期延长，表明需求回升背景下供应链仍处调整阶段，价格与成本压力有所上升。PMI 指数持续处于扩张区间通常表明制造业整体处于增长阶段，并与工业需求及宏观经济扩张具有较强相关性，对半导体及电子产业需求形成重要支撑。

全球各地区制造业 PMI

时间	全球	中国	日本	韩国	印度	美国	欧元区
2023-11	49.30	49.40	48.30	50.00	56.00	46.70	44.20
2023-12	49.00	49.00	47.90	49.90	54.90	47.40	44.40
2024-01	50.00	49.20	48.00	51.20	56.50	49.10	46.60
2024-02	50.30	49.10	47.20	50.70	56.90	47.80	46.50
2024-03	50.60	50.80	48.20	49.80	59.10	50.30	46.10
2024-04	50.30	50.40	49.60	49.40	58.80	49.20	45.70
2024-05	50.90	49.50	50.40	51.60	57.50	48.70	47.30
2024-06	49.50	49.50	50.00	52.00	58.30	51.70	45.60
2024-07	49.80	49.40	49.10	51.40	58.10	46.80	45.80
2024-08	48.90	49.10	49.80	51.90	57.50	47.20	45.60
2024-09	48.80	49.80	49.70	48.30	56.50	47.20	45.00
2024-10	48.80	50.10	49.80	48.30	57.50	46.50	46.00
2024-11	50.00	50.30	49.00	50.60	56.50	48.40	45.20
2024-12	49.60	50.10	49.60	49.00	56.40	49.20	45.10
2025-1	50.10	49.10	48.70	50.30	57.70	50.90	46.60
2025-2	50.60	50.20	49.00	49.90	56.30	50.30	47.60
2025-3	50.30	50.50	48.40	49.10	58.10	49.00	48.60
2025-4	49.80	49.00	48.70	47.50	58.20	48.70	49.00
2025-5	49.60	49.50	49.40	47.70	57.60	48.50	49.50
2025-6	50.30	49.70	50.10	48.70	58.40	49.00	50.50
2025-7	49.70	49.30	49.90	48.00	59.20	48.00	49.80
2025-8	50.90	50.50	52.00	48.30	59.30	53.00	50.70
2025-9	50.70	51.20	48.50	50.70	57.70	52.00	49.80
2025-10	50.90	50.60	48.20	49.40	59.20	52.50	50.00
2025-11	50.50	49.90	48.70	49.40	56.60	52.20	49.60
2025-12	50.40	50.10	50.00	50.10	55.00	51.80	48.80
2026-01	50.90	50.30	51.50	51.20	55.40	52.40	49.50

数据来源：Wind

● 2025 年全球半导体销售额达 7917 亿美元，同比增长 25.6%创历史新高

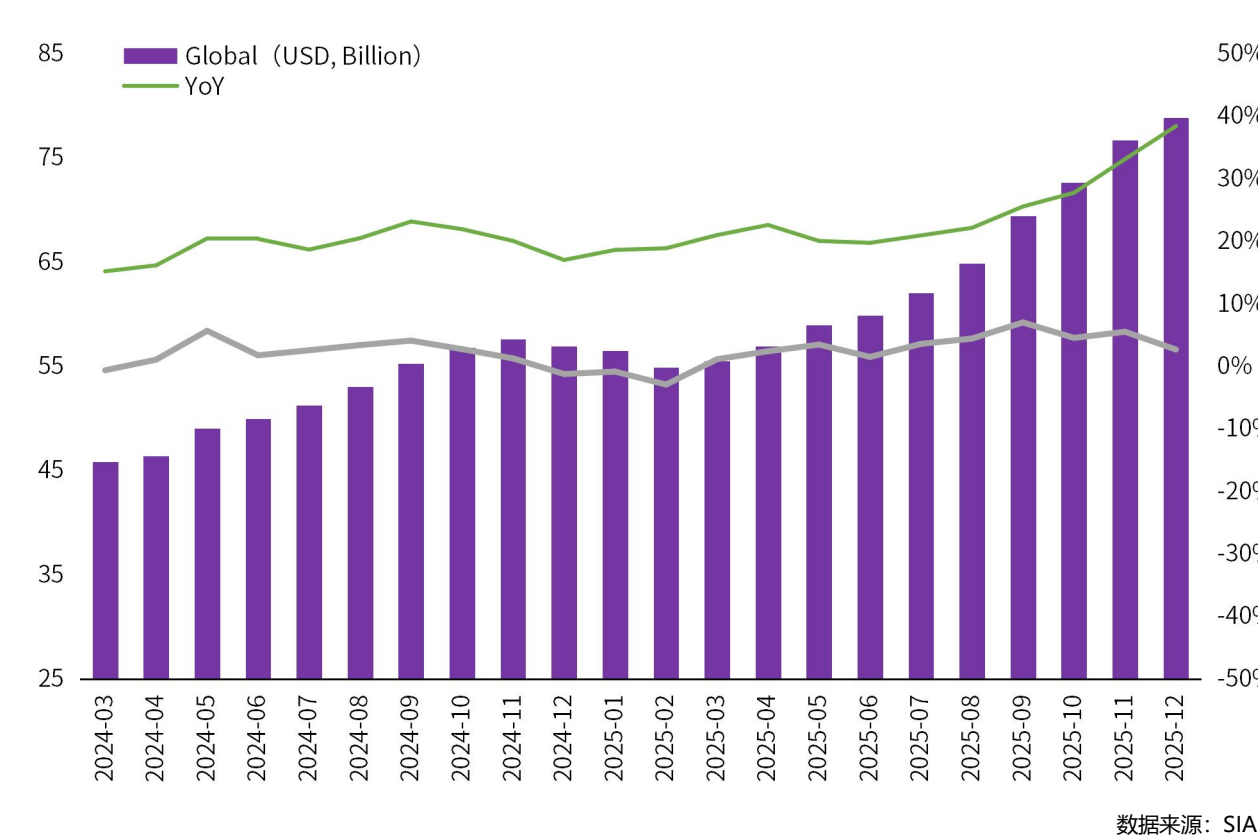
2025 年全球半导体行业销售额达 7917 亿美元，同比增长 25.6%，较 2024 年的 6305 亿美元显著提升，创下历史最高年度销售规模。第四季度销售额为 2366 亿美元，同比增长 37.1%，环比增长 13.6%；12 月单月销售额为 789 亿美元，环比增长 2.7%，显示行业增长动能持续增强。

从产品结构看，逻辑芯片与存储器为主要增长驱动力。逻辑芯片销售额达 3019 亿美元，同比增长 39.9%，成为销售规模最大的细分品类；存储器销售额达 2231 亿美元，同比增长 34.8%，位列第二。两大核心品类合计占据全球半导体市场重要份额，反映数据处理与存储需求持续扩张。

从区域表现看，亚太及其他地区年度销售额同比增长 45.0%，美洲增长 30.5%，中国增长 17.3%，欧洲增长 6.3%，日本同比下降 4.7%。区域销售结构变化显示全球半导体需求增长主要集中在亚太及美洲市场，相关地区在半导体制造、数据中心及电子产品生产中的重要性持续提升。

美国半导体行业协会预计，在人工智能、物联网、6G、自动驾驶等新兴技术需求驱动下，2026 年全球半导体销售额有望逼近 1 万亿美元。

全球半导体销售额（十亿美元）



● 美国 10 年期国债收益率 2 月震荡下行，地缘政治与关税不确定性主导避险行情

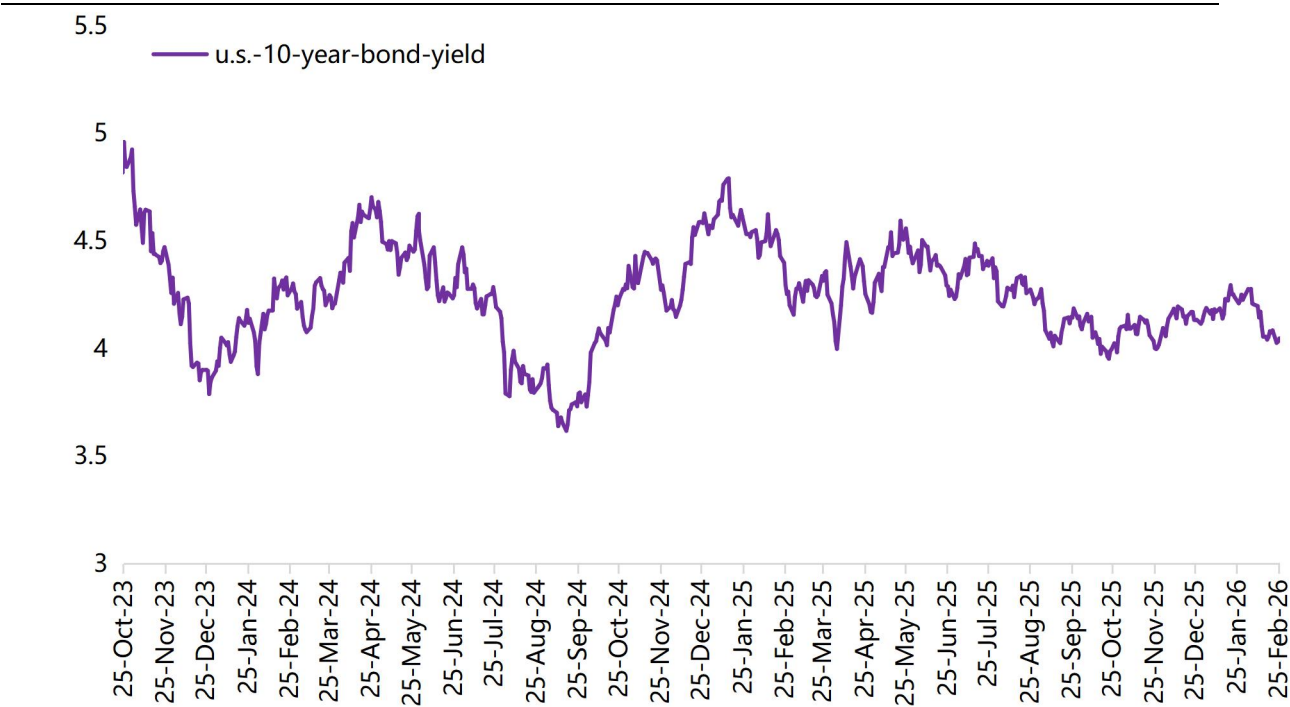
2026 年 2 月，美国 10 年期国债收益率呈震荡下行走势，逐步回落至 4.0% 附近。全月从月初 4.27% 波动下行，2 月 23 日一度触及 4.029% 的低点。截至 2 月 25 日，10 年期美债收益率报 4.048%，

较 1 月末累计下跌约 19 个基点，创近一年来最大单月跌幅。2 月下旬 10 年期与 2 年期利差维持在 +57.7 个基点，收益率曲线保持正常向上倾斜；10 年期通胀保值国债收益率维持在 1.76% 附近。

收益率下行主要受三重因素驱动：一是关税政策不确定性引发避险需求。2 月 20 日美国最高法院裁定特朗普政府依据《国际紧急经济权力法》实施的关税政策违法，裁决后特朗普政府援引《1974 年贸易法》签署行政令实施新 10% 全球基准关税，政策反复加剧市场不确定性，资金涌入美债避险。二是美伊紧张局势升级，美军在中东部署达近年最大规模，避险情绪推动美债买盘。三是经济数据表现分化：1 月 CPI 同比涨幅降至 2.4%，创 2025 年 5 月以来新低；第四季度 GDP 年化环比增长 1.4%，为 2025 年一季度以来最低增速；就业市场保持韧性，初请失业金人数维持在 20.6 万低位。

市场对美联储利率路径的预期随之调整。美联储 1 月会议纪要显示官员对降息持谨慎态度。期货市场定价显示，交易员预计 2026 年全年降息幅度约 60 个基点，相当于两次 25 个基点的降息。作为全球金融市场重要基准利率，10 年期美债收益率处于 4.0% 左右区间，对半导体等资本密集型产业的投融资环境具有重要参考意义。

美国 10 年期国债利率(%)



数据来源：Investing

● 费城半导体指数 1-2 月走势分析：突破 8000 点后震荡上行，AI 与存储驱动行业上行周期确立

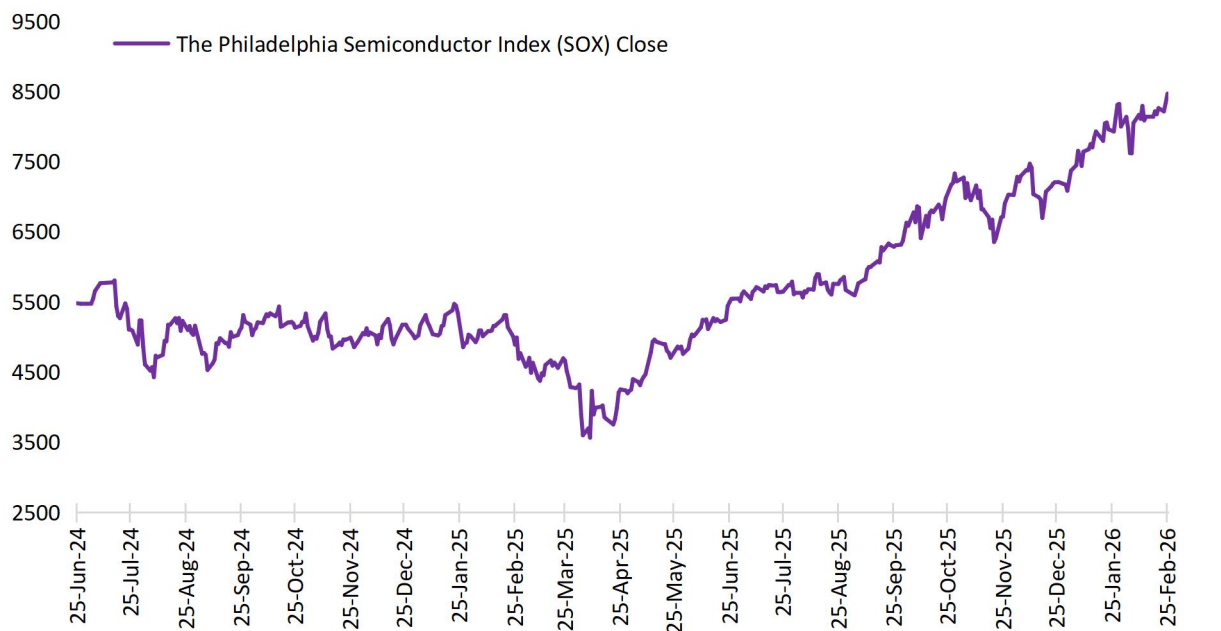
2026 年 1-2 月，费城半导体指数整体呈现突破关键整数关口后震荡上行并创出历史新高的结构性

上升趋势。2025 年 12 月 31 日指数收于 7083.13 点后，2026 年 1 月开启强势上涨行情，1 月 21 日指数上涨 3.18%至 8042.07 点，首次突破 8000 点整数关口并创下历史新高。此后指数继续震荡上行，1 月 29 日触及 8320.39 点的月内高点，月度累计涨幅达 12.9%。进入 2 月，指数经历先抑后扬的技术性调整，2 月 4 日下探至 7619.16 点，较 1 月末高点回撤约 8.4%，但随后迅速修复，2 月 6 日单日反弹 5.70%至 8048.62 点，重新站稳 8000 点上方。此后指数延续震荡上升态势，2 月 25 日收于 8467.43 点，再次刷新历史新高，较 2025 年末累计上涨约 19.5%。

从驱动因素来看，本轮指数上行主要由两大核心动力推动：一是 AI 算力需求持续扩张，云厂商资本开支增长及 AI 芯片采购需求强化，带动 GPU、先进逻辑及先进封装产业链景气度持续提升；二是存储芯片周期进入上行阶段，供给收缩与需求回暖推动存储价格上涨，强化行业盈利修复预期。从市场结构观察，本轮上涨呈现三个典型特征：趋势明确，指数从年末低位持续抬升，反映行业估值修复与盈利预期同步改善；波动中枢上移，尽管出现技术性回调，但低点逐步抬升，显示市场支撑力度增强；成功站稳 8000 点上方并继续走强，反映机构资金持续流入半导体板块。

整体而言，2026 年初费城半导体指数突破 8000 点并持续创出新高，标志着半导体行业进入新一轮上升周期。指数走势反映资本市场对行业周期复苏、AI 算力需求扩张及先进制造投资增长的高度认可，为行业资本开支及产业链景气度提供了重要的领先信号。

费城半导体指数(SOX)



数据来源：MacroMicro

二、半导体产业动态

半导体产业动态概览			
维度	厂商	经营动态	解读
短期影响	意法半导体 STMicroelectronics	与 AWS 签署数十亿美元战略合作	成为 AWS 核心供应商，产品+认股权证深度绑定，借 AWS 云加速芯片设计，切入 AI 供应链。
	英飞凌 INFINEON	4 月起上调功率器件价格，同时完成 ams OSRAM 传感器业务收购	功率率先提价，AI 需求+成本压力引爆跟涨潮；收购 ams OSRAM 传感器，布局汽车与物理 AI 感知技术。
	南亚科技 Nanya	Q4 营收季增 54.7%，营业利润率跃升至 39.1%	DDR4/DDR3 合约价暴涨，大客户积极补货，产能转至利润率最高的 DDR4，盈利能力跃升。
	亚德诺 ADI	Q1 营收 31.6 亿美元超预期，连续 22 年上调股息	工业+通信领跑，AI 相关业务年化超 20 亿美元；Q2 指引 35 亿美元远高预期，复苏动能强劲。
	三星电子 / SK 海力士 Samsung / SK Hynix	二季度 DRAM 价格涨幅高达 100%，卖方市场格局确立	三星对苹果报价提价 100%获接受，SK 海力士 DDR5 涨 40%；产能仅满足全球 60%需求，供需缺口达近 15 年峰值。
	士兰微/新洁能/宏微科技/华润微 Silan/NCE Power/MacroMicro/CR Micro	国产功率半导体厂商 2-3 月集体上调产品价格，涨幅普遍在 10%左右	士兰微、新洁能、宏微科技、华润微等国产功率龙头相继提价 10%，成本压力+AI 需求爆发，国产功率进入量价齐升周期。
	国巨/基美 Yageo/KEMET	4 月 1 日起上调 T523 系列钽电容价格，系 9 个月内第三次涨价	钽电容龙头 9 个月内第三次涨价，AI 服务器需求激增+成本压力，2026 年维持卖方市场。
中期影响	瑞萨电子 RENESAS	任命刘芳出任中国区总裁，并与格罗方德达成数十亿美元战略合作	前恩智浦高管接掌中国区强化本土决策，同时与格罗方德深度绑定获关键制程权限，内外并举锁定汽车与工业市场。
	SK 海力士 SK Hynix	追加 150 亿美元投资龙仁晶圆厂，HBM 产能提前释放	累计投资 215 亿美元，龙仁首厂洁净室提前至 2027 年 2 月启用，锁定 HBM4 及更高代次产能。
	台积电 TSMC	中国台湾地区十座晶圆厂同步推进，2nm 量产加速、CoWoS 产能年底达 14 万片	新竹/高雄领跑 2nm 量产，台中布局 1.4nm，嘉义/台南助推先进封装产能翻倍，全面锁定 AI 算力需求。
	德州仪器 Texas Instruments	以 75 亿美元现金收购芯科科技，强化无线连接业务	75 亿美元收购芯科科技，补强无线连接产品线，预计 2027 年完成，三年协同效应 4.5 亿美元。

	力积电 PSMC	与美光达成战略合作, 出售铜 锣厂并切入 HBM 供应链	16.79 亿美元出售铜锣厂予美光 (不含设备), 贡献 EPS 4.65 元; 切入 HBM 后段晶圆制造, 转型 AI 供应链。
长期 影响	英伟达 NVIDIA	Q4 营收 681 亿美元同比增 73%, 黄仁勋称"代理式 AI 拐点已至"	Q4 数据中心营收 623 亿美元创纪录, 超大规模客户贡 献超 50%; Q1 指引 780 亿美元, H20 在华收入 6000 万美元。
	超威半导体 AMD	Meta 与 AMD 达成 600 亿美 元 AI 芯片采购协议	五年期协议涵盖 MI450 GPU 及定制 CPU, 标志 AI 巨 头加速供应链多元化, 打破英伟达主导格局。
	三星电子 Samsung	Q4 DRAM 营收 193 亿美元, 季增 43%重返第一	Q4 DRAM 营收季增 43%重返第一, 售价增 40%居首, HBM 带动市占回升至 36%。
	美光 Micron	宣布 2000 亿美元美国本土扩 产计划, HBM4 已量产提前 出货	宣布 2000 亿美元美国扩产, 博伊西/纽约工厂推进; HBM4 量产提前一季, 2026 年产能已售罄。

(一) 短期影响

● 意法半导体：与 AWS 签署数十亿美元战略合作

2 月 9 日, 意法半导体宣布与亚马逊云服务 (AWS) 达成一项为期多年、价值数十亿美元的战略合作协议。根据协议, ST 将成为 AWS 计算基础设施的核心供应商, 提供包括高性能混合信号处理、智能微控制器及高能效功率 IC 在内的先进半导体产品, 助力 AWS 应对 AI 与云工作负载带来的性能挑战。作为合作的一部分, ST 向 AWS 发行了最多 2480 万股普通股的认股权证, 行权价 28.38 美元, 归属条件与 AWS 的采购付款挂钩。此外, 双方还将合作优化云上的电子设计自动化 (EDA) 工作负载, 利用 AWS 的可扩展计算能力加速 ST 自身的芯片设计周期。ST CEO Jean-Marc Chery 表示, 此次合作将 ST 置于 AI 革命的核心位置。市场反应积极, ST 股价在消息公布后上涨超 5%。

● 英飞凌：4 月启动功率器件涨价，完成 ams OSRAM 传感器业务收购，双轮驱动锁定 AI 与汽车赛道

2 月下旬至 3 月初, 英飞凌在功率半导体与传感器两大核心赛道同步发力。价格策略方面, 公司 2 月上旬率先宣布 4 月起上调部分功率产品价格, 引爆全球跟涨潮。英飞凌指出, AI 服务器单机功率已从传统服务器的数千瓦飙升至数十千瓦甚至兆瓦级, 碳化硅等高端产品需求激增。作为全球功率风向标, 此轮调价标志行业迈入“量价齐升”新周期。战略并购方面, 2 月 25 日以 5.7 亿欧元完成对 ams OSRAM 传感器业务收购, 涵盖磁性、电流、温度传感器等产品线, 预计 2026 年贡献约 2.3 亿欧元营收, 约 230 名研发

及管理人员加入，为汽车底盘检测、机器人关节控制等“物理 AI”领域储备关键感知技术。综合来看，英飞凌通过价格调整释放短期业绩弹性，通过战略并购锁定中长期技术护城河，双轮驱动布局 AI 与汽车两大高景气赛道。

● **南亚科技：Q4 营收季增 54.7%，营业利润率跃升至 39.1%**

根据 TrendForce 调查，南亚科技 2025 年第四季营收季增 54.7%至 9.70 亿美元，出货量季增低十位数百分比，ASP 上涨 30%以上，营业利润率自 6.0%大幅提升至 39.1%。公司官方财报显示，第四季营业收入为新台币 300.94 亿元，季增 60.3%，毛利率达 49.0%，税后净利为新台币 110.83 亿元，单季每股盈余 3.58 元。这一强劲表现反映 DDR4 及 DDR3 的合约价进一步巨幅上涨，大客户持续积极补货，公司积极将 20nm 及 1B 制程产能由 DDR3 及 DDR5 挪移至利润率最高的 DDR4 产品线。

● **亚德诺：Q1 营收 31.6 亿美元超预期，连续 22 年上调股息**

2 月 18 日，亚德诺半导体公布 2026 财年第一季度财报，营收达 31.6 亿美元，同比增长 30%，创近两年单季新高；毛利率 71.2%，每股收益 2.46 美元，同比增长 51%。公司宣布将季度股息上调 11%至 1.10 美元，连续第 22 年提高股息。从业务结构看，工业业务占比 47%，同比增长 38%，ATE 和航空航天与国防创季度新高；通信业务占比 15%，同比增长 63%，主要受 AI 基础设施投资驱动；汽车业务同比增长 8%，预计全年将超越 2025 年历史纪录；消费业务同比增长 27%。更值得关注的是，AI 相关业务（ATE+数据中心）合计贡献近 20%营收，年化规模超 20 亿美元，其中 ATE 业务 2025 财年增长约 40%并持续加速，数据中心业务增长约 50%且维持加速态势。展望第二季，公司预计营收达 35 亿美元，远超市场预期的 32.3 亿美元，其中工业业务预计环比增长 20%、同比增长 50%，通信业务预计同比增长约 60%。管理层表示订单与出货比远高于 1，所有工业细分领域均呈正向增长，但明确“目前未观察到任何补货迹象”。财务健康度方面，约三分之一第二季环比增长来自定价调整，库存周转天数 71 天，渠道库存维持 6-7 周健康区间，过去 12 个月自由现金流达 46 亿美元，占营收 39%，净杠杆率降至 0.8。

● **三星电子/SK 海力士：二季度 DRAM 价格涨幅最高达 100%，卖方市场格局确立**

3 月 1 日，三星电子与 SK 海力士正式向客户通知，第二季度 DRAM 价格继续大幅上调，部分产品涨幅高达 100%。SK 海力士 DDR5 颗粒统一涨价 40%，三星对苹果 LPDDR5X 报价提价 100%获无条件接受，凸显当前供应紧缺程度。业内人士透露，三星产能仅能满足全球 60%的 DRAM 需求，供需缺口达近 15 年峰值。AI 服务器单台 DRAM 用量是传统服务器的 8-10 倍，叠加 HBM 占用大量先进产能，普通 DRAM 库存仅剩 4 周左

右，远低于 8-12 周安全线。从价格走势看，DDR4 8Gb 颗粒从 2025 年 3 月的 1.3 美元飙升至 2026 年 2 月的 13 美元，累计涨幅近 10 倍。Gartner 预测到 2026 年底 DRAM 及 SSD 价格将较上年上涨 130%，涨价潮贯穿全年。本轮涨价系结构性供需失衡所致，三大巨头合计份额超 90%，2026 年产能仅增约 7%，远不及 AI 需求爆发。市场规则已被改写，大客户采购满足度仅 20-30%，中小企业需接受按月调价甚至“先拿货、后定价”条款，存储超级周期正快速传导至全产业链。

- **士兰微/新洁能/宏微科技/华润微：国产功率半导体厂商 2-3 月集体上调产品价格，涨幅普遍在 10%左右**

2026 年 2 月至 3 月初，国产功率半导体行业迎来新一轮集体涨价潮。士兰微、新洁能、宏微科技、华润微等多家龙头企业相继发布价格调整通知，涨幅普遍在 10%左右，涉及小信号二极管、MOSFET、IGBT 等核心功率器件，标志着国产功率行业正式进入量价齐升新周期。

本轮涨价由两大核心因素驱动：一是成本端压力传导，全球铜、铝、钯、银等封装关键金属材料价格持续攀升，中小功率器件中封装成本占比高达 60%-80%；二是需求端结构性爆发，AI 数据中心带来海量新增需求，单台 AI 服务器功率器件价值较传统产品提升近 5 倍，叠加新能源汽车、工业控制等基本盘稳固，供需格局发生逆转。

各家厂商各有侧重：士兰微 3 月 1 日起对小信号二极管及 MOS 类芯片提价 10%，6 英寸 SiC-MOSFET 月产能已达 1 万片；新洁能同步对 MOSFET 涨价 10%，直言上游原材料价格攀升导致成本承压；宏微科技自 3 月起对 IGBT 及 MOSFET 提价约 10%，股价应声大涨；华润微 2 月 1 日率先涨价超 10%，第三代 MOS G4 已批量上车，2026 年 SiC/GaN 业务有望翻倍。

此轮涨价潮紧随国际龙头英飞凌之后形成全球共振，国产功率半导体已告别价格博弈阶段。涨价推动产业链结构性分化，上游材料与设备商直接受益，硅基器件涨价与 SiC 规模化降价形成剪刀差，第三代半导体渗透率加速提升。士兰微、华润微等已形成规模化三代半产能布局，正加速打破海外巨头垄断格局。

- **国巨/基美：4 月 1 日起上调 T523 系列钽电容价格，系 9 个月内第三次涨价**

3 月初，国巨旗下基美宣布对聚合物钽电容 T523 系列调涨价格，4 月 1 日生效。这是 2025 年下半年以来第三次涨价，前两次分别在 2025 年 6 月（涨幅双位数）和 11 月（涨幅 20-30%）。基美称涨价系因过去三年需求激增，叠加人力、原材料及设备成本持续上升。

本轮涨价由 AI 服务器需求驱动。钽电容因高耐温、高稳定特性，被大量导入 AI 服务器，主流 GB300 机柜单柜用量超 5000 颗，2026 年 TPU 服务器用量更将超越 GPU。供给端，钽电容扩产周期长、设备投资高，全球市场由基美、AVX、Vishay 主导，合计市占率 60-70%，其中基美份额超 50%，增产 30%后产能仍全数售罄，2026 年供需缺口难以缓解。钽电容现为国巨第二大产品线，2025 年 Q4 营收占比 21.7%，仅次于磁性组件。供应链预期，在 AI 需求持续放量、产能难以快速开出的背景下，钽电容 2026 年将维持卖方市场格局。

（二）中期影响

● 瑞萨电子：任命刘芳出任中国区总裁，并与格罗方德达成数十亿美元战略合作

2 月至 3 月初，瑞萨电子在组织架构与供应链层面同步发力，全面锁定汽车与工业两大核心赛道。

组织架构层面，3 月 2 日瑞萨任命刘芳出任中国区总裁，26 年行业经验、前恩智浦大中华区汽车业务总经理背景，与印度换帅同步推进并直接向 CEO 汇报，旨在将中国区从“销售中心”升级为“战略中心+决策中心”，深化国内车企合作、强化 R-Car 智能驾驶芯片竞争力。

供应链层面，2 月 17 日与格罗方德达成数十亿美元合作，获 FDX™ FD-SOI、BCD 等特色制程权限，用于生产 SoC、功率器件和 MCU，流片预计 2026 年启动。产能由美、德、新及中国合作伙伴支持，并考虑引入日本自有晶圆厂，为 ADAS、电气化等提供长期供应保障。

两条动态分别解决“市场端”本土化响应与“供给端”产能保障，构建从需求洞察到全球交付的完整闭环，应对软件定义汽车与电气化转型的结构性机遇。

● SK 海力士：追加 150 亿美元投资龙仁晶圆厂，HBM 产能提前释放

2 月 25 日，SK 海力士宣布追加投资约 21.6 万亿韩元（约合 150 亿美元）用于龙仁首座晶圆厂建设，累计投资达 31 万亿韩元（约合 215 亿美元）。该投资将完成主体结构并兴建 5 座无尘室，最终形成 2 栋主体建筑及 6 座无尘室规模。首个无尘室启用时间从原定 2027 年 5 月提前至同年 2 月，产能释放节奏全面提速。从战略布局看，SK 海力士正加速向“AI 存储定制化”转型，龙仁集群作为耗资 600 万亿韩元的产业生态核心，将确保 1c nm 等下一代 DRAM 工艺的竞争力。后端封测方面，同步推进韩国清州与美国印第安纳州基地建设，并与台积电协作。目前公司形成明确产能梯队：利川 M16

与清州 M15X 满足当前 HBM 需求，龙仁首厂定位为 HBM4 及更高代次产品的旗舰基地。

● **台积电：中国台湾地区十座晶圆厂同步推进，2nm 量产加速、CoWoS 产能年底达 14 万片**

2 月下旬，台积电在中国台湾地区的大规模产能扩张计划全面浮出水面。2026 年台积电有望同步推进最多十座晶圆厂的在建与启动，全面覆盖 2nm、A16 及 A14 等尖端制程，并同步加码先进封装产能以应对 AI 芯片需求的爆炸式增长。在新竹宝山，2nm 量产基地 Fab 20 已进入量产阶段，预计月产能可达 2 万至 2.5 万片，其第三、四座晶圆厂正进行土木工程；在高雄，聚焦 2nm 及 A16 制程的 Fab 22 厂区进展迅猛，首座已量产、第二座进入试产、第三座主体封顶、第四五座已动工，预计 2027 年第四季度前五座工厂将全面投产；在台中，面向 1.4nm 的 Fab 25 项目已启动，规划四座晶圆厂，预计 2028 年下半年量产。先进封装方面，台中 AP5B 厂定于 2026 年内完工，嘉义 AP7 厂一期工程近尾声、二期已通过环评，台南 AP8 厂 P2 项目已获建筑许可。为满足强劲 AI 需求，台积电正加速扩增 CoWoS 产能，法人预估年底月产能将达 14 万片，随着嘉义、台南厂区明年底全面量产，CoWoS 总产能有望进一步推升至每月 17 万片。资本支出方面，台积电 2026 年预计达 520 亿至 560 亿美元，创历史新高，同比增长至少 27%；1 月合并营收达新台币 4,012.55 亿元（约 127 亿美元），同比增长 36.8%，创单月历史新高；受益于此轮扩产与 AI 需求驱动，股价 2 月 25 日盘中突破 2000 元新台币大关，收盘 2015 元。此次大规模、多地点扩张，不仅有效提升产能、增强供应链韧性，更凸显台积电巩固先进制程与封装领导地位、锁定 AI 算力长周期需求的坚定决心。

● **德州仪器：以 75 亿美元现金收购芯科科技，强化无线连接业务**

2 月 4 日，德州仪器宣布已签署最终协议，计划以约 75 亿美元现金收购芯科科技 (Silicon Labs)，为芯科科技股东提供每股 231 美元的现金对价。此次收购旨在加强德州仪器的嵌入式处理业务，提升在无线连接领域的市场地位。芯科科技的芯片业务主要服务于智能家居设备、工业自动化、电池储能系统及商业照明等连接性应用市场，拥有约 1200 种无线连接产品。交易预计于 2027 年上半年完成，尚待芯科科技股东及监管机构批准。德州仪器计划通过现有现金储备及新增债务融资完成此次收购，并预计在交易完成后的三年内产生约 4.5 亿美元的年化制造与运营协同效应。

● **力积电：与美光达成战略合作，出售铜锣厂并切入 HBM 供应链**

2 月 10 日，力积电与美光签署战略合作协议，正式切入 AI 内存供应链。根据公告，力

积电以 16.79 亿美元将铜锣厂厂房及厂务设施出售予美光，交易不含生产设备，预计处分利益达新台币 196.47 亿元，贡献 EPS 约 4.65 元，同时保留产能灵活调整空间。技术层面，双方围绕先进 DRAM 封装展开协同，力积电将设置专线支援美光 HBM 后段晶圆制造，纳入其全球先进封装供应体系；美光则协助力积电竞进利基型 DRAM 制程，突破 2X 纳米瓶颈。战略层面，力积电目标“转型跻身 AI 供应链”，目前 3D AI 代工业务占营收约 3%，计划三年内提升至 20%。受多重利好推动，力积电 1 月营收达 46.18 亿元，创 39 个月新高。此次合作标志着存储与代工融合发展的新阶段。

（三）长期影响

- **英伟达：Q4 营收 681 亿美元同比增 73%，黄仁勋称“代理式 AI 拐点已至”**

2 月 25 日美股盘后，英伟达发布 2026 财年第四季度财报，营收达 681.27 亿美元，同比增长 73%、环比增长 20%，超出市场预期的 658 亿美元；GAAP 净利润 429.60 亿美元，同比增长 94%；非 GAAP 每股摊薄收益 1.62 美元，同比增长 82%。全年营收首次突破 2000 亿美元至 2159.38 亿美元，同比增长 65%。数据中心业务再创纪录，第四季度营收 623 亿美元，同比增长 75%，占总营收 91%，超大规模云服务商贡献略高于 50%。黄仁勋在电话会上强调：“代理式 AI 的拐点已经到来，配备 NVLink 的 Grace Blackwell 芯片将每个 token 的成本降低一个数量级，客户正竞相投资 AI 算力”，并回应市场对资本支出见顶的担忧称“在 AI 新时代，算力即营收”。公司预计 2027 财年第一季度营收达 780 亿美元（±2%），远超市场预期的 728 亿美元，该指引未计入来自中国的数据中心收入。下一代芯片 Vera Rubin 样品已交付客户，量产计划于 2026 年下半年推进。中国业务方面，财报披露 H20 收入约 6000 万美元，H200 尚未产生收入。其他业务中，游戏营收 37 亿美元（同比增 47%），专业可视化 13 亿美元（同比增 159%），汽车与机器人 6.04 亿美元（同比增 6%）。2026 财年英伟达通过股票回购和分红向股东返还 411 亿美元，剩余回购授权 585 亿美元。

- **超威半导体：Meta 与 AMD 达成 600 亿美元 AI 芯片采购协议**

2 月下旬，AMD 与 Meta 达成一项为期五年的战略协议，Meta 将向 AMD 采购价值 600 亿美元的 AI 芯片，约占 AMD 芯片产能的 10%。这一交易被 AMD 首席执行官苏姿丰形容为“Meta 对 AMD 下的大赌注”。协议涵盖 AMD 即将推出的 MI450 系列 GPU 及定制化 CPU，其中 MI450 将于 2025 年下半年开始交付 1GW 算力规模的芯片。Forrester 分析师 Alvin Nguyen 指出，此举反映了 Meta AI 战略的调整：从与 OpenAI、

Anthropic 等竞争对手正面竞争，转向聚焦 AI 基础设施服务。更重要的是，这笔交易标志着领先 AI 玩家开始加速芯片供应链多元化——OpenAI 此前已与 AMD 达成类似合作，而 Meta 同时与英伟达、谷歌（TPU）保持谈判。随着美国科技巨头 2026 年预计投入 6600 亿美元于 AI 资产，AMD 正借英伟达供应瓶颈之机，重塑 AI 芯片市场格局。

● 三星电子：Q4 DRAM 营收 193 亿美元，季增 43%重返第一

根据 TrendForce 调查，三星 2025 年第四季 DRAM 营收增加至 193.0 亿美元，季增幅高达 43.0%，营收市占回升 3.4 个百分点至 36.0%，排名重返第一。售价季增约 40%、居三大原厂之首，位元出货量受到 HBM 业务带动，季增低个位数百分比，符合公司指引。三星的强劲表现得益于其在 HBM 领域的持续投入，以及 DRAM 市场整体供不应求的有利环境。

● 美光：宣布 2000 亿美元美国本土扩产计划，HBM4 已量产提前出货

2 月中旬，美光科技宣布了一项高达 2000 亿美元级别的长期资本开支计划，用于在美国本土新建和扩建先进存储制造工厂，以应对 AI 驱动的内存需求激增。该计划包括：爱达荷州博伊西总部投资 500 亿美元新建两座晶圆厂，预计 2027 年中投产、2028 年底全面达产，月产能可达 15 万至 20 万片晶圆，推动美光全球总产量提升 40%；纽约州雪城投资约 1000 亿美元破土动工全新晶圆厂综合体，规划四个洁净室设施，为纽约州史上最大私人投资；同步推进日本广岛近 10 亿美元投资及中国台湾地区购厂扩产。负责该计划的副总裁表示，从训练转向推理带来数据量猛增，现有洁净室产能严重不足。与此同时，美光 HBM4 内存已实现大规模量产并开始交付，进度较预期提前一季，2026 自然年 HBM 产能已全部售罄，部分重要客户仅能满足其需求量的一半至三分之二。这一“扩产+技术领先”的组合拳，标志着美光正全力押注 AI 内存“超级周期”。

三、终端市场动态

终端市场动态概览		
类别	厂商	11 月市场动态
人工智能	亚马逊 (AWS)	OpenAI 与亚马逊达成 2GW 算力合作; AWS 自研芯片正式打入顶尖 AI 实验室核心环境。
	Meta	Meta 签署 600 亿美元协议部署 6GW AMD 加速器; 通过多元化布局打破英伟达垄断, 强化供应链韧性。
	Microsoft (微软)	微软 Q2 资本支出达 375 亿美元, 投向算力资产; 自研 Maia 200 芯片正式部署, 以应对 6,250 亿美元订单积压并支持 GPT-5.2 推理。
	Google (谷歌)	Alphabet 投入 1,850 亿美元创纪录资本支出; 规模化 TPU (Ironwood) 平台, 支撑 Gemini 及 Meta、Anthropic 等核心客户
	Huawei (华为)	华为 MWC 首发 Atlas 950 SuperPoD; 通过 UnifiedBus 实现 8,192 颗芯片互联, 交付 “开箱即用” 的算力工厂方案。
	CoreWeave	CoreWeave 计划 2026 年 CapEx 翻倍至 350 亿美元, 引发利润率担忧并致股价大跌 18%; 激进采购硬件以稳固集群领先地位, 财务压力显著增加。
	Cambricon (寒武纪)	寒武纪 2025 年营收 64.97 亿元 (增 453.2%), 归母净利 20.6 亿元, 实现上市后首度全年盈利。
机器人	Tesla (特斯拉)	特斯拉改建弗里蒙特工厂为 Optimus 制造中心; 第三代人形机器人计划 2026 年上市, 目标年产 100 万台、成本控制在 2 万美元以内。
	Unitree (宇树科技)	宇树科技上调 2026 年全球出货目标至 1-2 万台; 凭借 1.35 万美元起售价, 产品正加速渗透教育与初级工业市场
	Agibot (智元机器人)	智元机器人联合敏实集团进军德国; 利用其欧洲工厂网络实现大规模部署, 攻克高精度汽车组装任务。
	Agibot (智元机器人)	智元机器人联合策安集团启动樟宜机场 T5 试点; Expedition A2 完成 106 公里长程测试, 验证复杂高安环境下的商业可靠性。
汽车	比亚迪 (BYD)	比亚迪 3 月 5 日发布 “代际跨越” 技术体系; 正式推出兆瓦级闪充 2.0 及第二代刀片电池, 通过端到端大模型智驾开启技术新周期。
	特斯拉 (Tesla)	特斯拉停止 FSD 买断并全面转向 99 美元/月订阅制; 旨在通过降低门槛提升渗透率, 为 AI 算力扩张提供持续现金流。

	小米汽车 (Xiaomi Auto)	小米 2026 交付 55 万辆 (+34%)；设立慕尼黑研发中心，推增程 SUV 等四款新车。
	理想汽车 (Li Auto)	理想推送 OTA 8.3 并引入 VLA 大模型；实现智驾从“规则驱动”向“感知-决策一体化”的关键跃迁。
	小鹏汽车 (XPENG)	小鹏第二代 VLA 适配图灵芯片开启量产；软硬协同提升 12 倍运行效率，加速全场景无图智驾落地。
	瑞萨电子 (Renesas)	瑞萨电子任命刘怡静（原恩智浦高管）为中国区总裁，同步升任 Malini 为印度区总裁。此举通过资深人才的本土洞察，加速汽车 (EV)、工业及智驾 SoC 市场的战略执行。
工业	富士康 (Foxconn)	富士康斥资 4.5 亿美元在休斯顿建立 AI 服务器工厂并首推“物理 AI”战略；通过大模型与工业机器人深度融合，推动“黑灯工厂”从自动化向自主智能化跨越。
	西门子 (Siemens)	西门子 Questa One 引入“自主工程智能体”，实现芯片验证从被动辅助向自主决策的跨越，标志着 EDA 行业进入 AI Agent 闭环驱动新阶段。
医疗	迈瑞医疗 (Mindray)	迈瑞医疗在埃及建立智能医疗培训基地；通过研发“区域适应性 AI 算法”优化特定族群识别，加速医疗解决方案的全球本土化落地。
	西门子医疗 (Siemens Healthineers)	西门子医疗在爱尔兰建立免疫分析卓越中心，通过 Atellica 系列“研产一体化”缩短产品上市周期。
	GE 医疗 (GE HealthCare)	GE 医疗推出搭载 Verisound 技术的下一代 LOGIQ 超声系统，通过 AI 提升肝病诊断精度并实现流程自动化。

（一）人工智能

● 亚马逊与 OpenAI 达成 1000 亿美元战略联盟，部署 2GW Trainium 计算能力

亚马逊（AWS）和 OpenAI 宣布达成一项历史性的多年合作协议，亚马逊将向 OpenAI 投资 500 亿美元。作为协议的关键部分，OpenAI 承诺使用约 2 吉瓦（2GW）的计算能力，这些计算能力由亚马逊自主研发的 Trainium 芯片提供支持。此次合作旨在共同创建一个用于人工智能代理的“有状态运行时环境”，标志着 OpenAI 在利用 AWS 定制芯片以降低成本和提高长期扩展效率方面迈出了重要一步。

● Meta 与 AMD 合作部署 6 吉瓦 Instinct MI450 加速器

Meta 宣布与 AMD 达成一项广泛的战略合作，将利用 AMD Instinct MI450 平台部署 6 吉瓦（6GW）的 AI 计算能力。作为 AI 硬件的大型“客户”，Meta 正积极实现供应链多元化，以降低其对 NVIDIA 近 90% 的依赖。这些基于 AMD 的集群将集成到 Meta 的全球 Llama-4 训练和推理基础设施中，进一步巩固 Meta 在开源 AI 部署领域的领导地位。

● 微软将 Maia 200 AI 加速器商业化，为 GPT-5.2 和 Copilot 服务提供支持。

微软正式开始在 Azure 数据中心大规模部署其新一代 Maia 200 AI 加速器。这款基于 3nm 工艺的芯片专为海量推理而设计，目前已为 GPT-5.2 和 Microsoft 365 Copilot 提供强大支持。微软表示，Maia 200 与其软件栈的紧密集成，可使每个令牌的运营成本降低 30%，从而为其 AI 用户群提供可持续的基础设施。

● Alphabet 计划在 2026 年投入创纪录的 1850 亿美元用于全球人工智能基础设施建设

Alphabet（谷歌）大幅扩展了其 2026 年的投资路线图，承诺投入创纪录的 1850 亿美元资本支出（CapEx），用于其数据中心和云基础设施的全球扩张。这项巨额支出旨在

为其 Gemini 3.1/3.2 模型提供必要的计算能力,并通过托管 Anthropic 和 Meta 等高容量外部客户,将谷歌打造成为“全球人工智能公用事业公司”。通过在新庞大的基础设施上扩展其专有的 TPU (Ironwood) 硬件,谷歌旨在将其巨额研发投入转化为高利润的云租赁收入,从而确保其在全球人工智能供应链中的长期主导地位。

- **华为在 2026 年世界移动通信大会 (MWC 2026) 上发布 Atlas 950 SuperPoD, 提供 8192 节点统一集群**

在 2026 年 3 月 2 日于巴塞罗那举行的世界移动通信大会 (MWC) 上,华为正式发布了 Atlas 950 SuperPoD。该系统采用华为自主研发的 UnifiedBus 技术,可实现单个逻辑集群最多 8192 个 NPU,并具备超高带宽和统一内存寻址能力。该产品定位为面向全球电信运营商和政府客户的“交钥匙”计算工厂,为大规模训练和推理提供高性能解决方案。

- **CoreWeave 股价暴跌 18.5%, 巨额 2026 财年支出计划令投资者担忧**

人工智能云基础设施提供商 CoreWeave 宣布将 2026 财年的资本支出 (CapEx) 翻番后,其股价大幅下跌。此举旨在积极拓展全球业务,并确保获得尖端人工智能硬件以满足激增的需求,但却在资本市场适得其反。投资者反应消极,普遍担忧如此大规模的支出增长将严重侵蚀公司的利润率,并在竞争日益激烈的云市场环境中加剧其现金流压力。

- **寒武纪科技 2025 年营收同比增长 453%, 实现全年盈利, 人工智能蓬勃发展**

寒武纪科技于 2026 年 2 月 27 日发布了 2025 年业绩报告,显示其营收同比增长 453.2%,达到人民币 64.97 亿元。这是该公司上市以来首次实现全年净利润。这一财务好转主要得益于其思源系列芯片被字节跳动、百度等中国互联网巨头大规模采用,标志着其人工智能硬件已从测试阶段过渡到面向国内市场的稳定、大规模商业化生产阶段。

(二) 机器人

- **特斯拉以 Optimus 生产线取代 Model S/X 生产线, 助力实现百万级年产量**

特斯拉正式启动一项重大战略转型, 将其弗里蒙特工厂的部分区域——特别是原本用于生产小批量 Model S 和 Model X 的生产线——改造为 Optimus 人形机器人的高产能生产线。此举旨在支持埃隆·马斯克实现年产量 100 万台的长期愿景。目前, 第二代 Optimus 已在特斯拉的工厂车间投入使用, 执行诸如电池分拣和处理精密部件等实用自主任务, 以完善其神经网络。即将于 2026 年亮相的第三代 Optimus 将从零开始设计, 以实现大规模商业化, 配备更先进的手部系统, 旨在达到人类水平的熟练程度。特斯拉将 Optimus 的单价目标设定在 2 万美元左右, 这不仅意味着 Optimus 是一款工厂助手, 更是一款革命性的“物理人工智能”产品, 其最终市值甚至可能超过特斯拉的汽车业务。

- **春节联欢发布会后, Unitree G1 订单激增**

在 2026 年农历新年晚会上, 杭州优尼特机器人公司 (Unitree Robotics) 的 G1 人形机器人凭借其精彩的表演迅速走红网络, 订单量也随之激增。这款售价约为 12,300 美元的 G1 机器人, 在极寒天气 (-47.4°C) 下成功展示了武术和高冲击力动作等先进技能。优尼特首席执行官王星星透露, 继 2025 年出货量超过 5,500 台之后, 公司已设定了 2026 年 2 万台的宏伟目标, 以满足不断增长的工业和消费市场需求。

- **Agibot 进军德国市场, 并与 Minth 集团合作进行工业部署**

Agibot 在慕尼黑举行发布会, 正式宣布进军德国市场。该公司展示了其全线产品, 包括 G2 系列工业人形机器人, 并与全球领先的一级汽车供应商敏特集团签署了战略合作协议。此次合作旨在将 Agibot 的具身人工智能技术部署到敏特集团的欧洲制造工厂, 这标志着中国人形机器人在高精度汽车供应链领域的发展迈出了重要一步。

- **Agibot Expedition A2 完成 106 公里耐力测试, 并将业务拓展至东南亚。**

2026 年 2 月, Agibot 的 Expedition A2 人形机器人成功完成了从苏州到上海的 106 公里长途跋涉, 证明了其在复杂城市环境中的机械可靠性。与此同时, Agibot 拓展了

其在东南亚的客户端业务，与 Certis 集团合作，在新加坡樟宜机场 5 号航站楼展示了其机器人技术。截至 2026 年初，Agibot 的全球出货量已超过 5000 台，预计到 2025 年将占据人形机器人市场 39% 的份额。

（三）汽车

● 比亚迪将于 3 月 5 日举办“惊悚”技术发布会，推出下一代平台

比亚迪正式确认将于 2026 年 3 月 5 日举行重大技术发布会。此次发布会旨在巩固比亚迪的技术领先地位，重点推出四项核心颠覆性硬件和平台升级：兆瓦级快充 2.0 基础设施、第二代刀锋电池、DM 6.0 插电式混合动力系统以及升级版 DiPilot 5.0 智能驾驶辅助系统。通过整合这些创新技术，比亚迪旨在通过提升充电效率、能量密度和自主决策能力，稳定市场需求，并重新定义其高销量车型阵

● 特斯拉 FSD 订阅：硬件优先模式

特斯拉正式将其 FSD (Supervised) 套件的订阅模式改为每月 99 美元，逐步取消一次性购买选项。此举，加上 FSD V12.5 的性能提升，旨在最大化每辆车的长期经常性收入。芯片洞察：这一策略将 OEM 采购模式转变为“硬件优先，软件后置”。OEM 厂商现在在工厂组装过程中会过度配置芯片（例如，更高的 LPDDR5 密度和更大的 NPU 余量）。这为芯片供应商提供了可预测的长期需求稳定性，因为每辆车现在都被设计成“订阅就绪”的 SaaS 终端。

● 小米汽车慕尼黑研发中心助力其全球扩张，年产量有望达到 55 万辆

小米汽车确认了其 2026 年交付 55 万辆的目标，并宣布在慕尼黑设立研发中心。此举旨在提升其全球合规性，并使其“人车家”生态系统更好地适应欧洲市场。芯片洞察：随着年产量接近 50 万辆，小米已晋升为“一级”战略客户。芯片供应商必须调整其产品路线图——特别是高性能座舱 SoC 和增程式电动汽车 (EREV) 动力电子芯片——以适应小米快速的多车型迭代节奏，从而确保获得至关重要的市场份额。

- **理想汽车发布搭载 VLA 模型的 OTA 8.3 系统，2 月交付量达 26,421 辆**

理想汽车发布了 OTA 8.3 系统，集成了 VLA（视觉-语言-动作）模型，以实现语义决策。

与此同时，小鹏汽车于 3 月 2 日发布了第二代 VLA 模型，该模型针对其自主研发的图灵 AI 芯片（拥有 2,250 TOPS 的运算能力）进行了专门优化。芯片洞察：VLA 模型标志着人工智能从“感知型 AI”向“推理型 AI”的结构性转变。这立即对统一的内存架构和专用 Transformer 硬件加速器提出了更高的要求，以处理低延迟推理。无法提供能够最大限度降低 VLA 模型端到端延迟的芯片的厂商，将面临被选择自行开发内部 AI 芯片的客户所取代的风险。

- **小鹏汽车发布搭载 2250 TOPS 图灵芯片的第二代 VLA，助力 L4 级自动驾驶**

小鹏汽车公布了其 2026 年 2 月交付成果，交付量达 15256 辆，标志着 P7+ 车型正式面向全球 18 个国家/地区交付。3 月 2 日，在广州举行的一场备受瞩目的媒体发布会上，小鹏汽车发布了其第二代 VLA 模型，该模型代表了“物理 AI”架构的重大突破。第二代 VLA 消除了旧系统中存在的中间“语言翻译”步骤，实现了从视觉信号到车辆控制指令的端到端直接生成。该模型针对小鹏汽车自主研发的图灵 AI 芯片进行了优化，该芯片可提供高达 2250 TOPS 的计算能力。这种垂直整合使得基于 6.5 万年人类驾驶数据训练的 VLA 2.0 能够在“Ultra”系列车型上本地运行，为 L4 级自动驾驶和未来的 Robotaxi 运营奠定了技术基础。

- **瑞萨电子加强在中国和印度的领导地位，以推动汽车行业增长**

2026 年 3 月 1 日，瑞萨电子宣布任命刘亦芬（原恩智浦大中华区汽车业务负责人）为瑞萨中国总裁，并任命马利尼·纳拉亚纳穆尔蒂为瑞萨印度总裁。此次高层领导调整标志着瑞萨电子战略转型，旨在深化其在亚洲关键汽车市场的业务布局，利用本地工程人才和已建立的 OEM 合作关系，在日益激烈的市场竞争中加速部署其 R-Car SoC 平台和软件定义汽车（SDV）解决方案。

(四) 工业

● 富士康：通过休斯顿人工智能服务器扩展“物理人工智能”

富士康宣布投资 4.5 亿美元扩建其位于休斯顿的 AI 服务器工厂，并正式启动“物理 AI”战略。该战略的核心是利用 NVIDIA Isaac GR00T-N 型人形机器人，在 2026 年第一季度于其生产线上大规模部署人形机器人。富士康的目标是使机器人能够感知和理解物理定律，从而实现从“无人值守工厂”中简单的重复性自动化向具备感知能力的智能自主生产的飞跃。芯片洞察：此举将显著提升对边缘 AI 加速器和高性能伺服驱动芯片的需求。物理 AI 要求机器人在本地处理海量的视觉和物理仿真数据，这为具有高带宽内存接口的工业级 SoC 芯片提供了核心增长点。

● 西门子推出 Questa One 智能人工智能工具包，实现芯片验证自动化

西门子于 2026 年 2 月 27 日正式发布 Questa One 工具包，标志着其 EDA（电子设计自动化）战略从生成式助手向“智能体 AI”转型。该平台集成了 NVIDIA NIM 微服务，使 AI 智能体能够在 Xcelerator 平台上自主执行复杂的推理、电路仿真和 RTL 验证。通过超越简单的文本生成，实现工程工作流程的自主执行，西门子旨在显著减少验证瓶颈，并加速下一代半导体和 PCB 的设计到芯片的开发周期。

(五) 医疗

● 迈瑞在埃及设立研发基地，以实现智能影像和 ICU 解决方案的本地化。

迈瑞医疗已与埃及卫生部达成协议，将在埃及建立一个专门用于智能影像和智能 ICU 系统的研发培训基地。这一战略举措标志着迈瑞的研发重点转向“区域化 AI 算法”，例如针对特定族群和当地临床环境优化的图像识别模型。通过将研发直接融入新兴市场，迈瑞旨在弥合高端医疗技术与区域医疗保健需求之间的差距，重点关注自主诊断效率和智能 ICU 工作流程的整合。

● 西门子医疗斥资 1000 万欧元开设卓越中心，整合研发与生产线

西门子医疗在爱尔兰斯沃兹正式启用其耗资 1000 万欧元的全新免疫分析研发卓越中心。该中心致力于开发基于 Atellica 平台的下一代诊断仪器，并将实验室研究与先进的生产线直接整合。这种“从研发到产品上市”的协同模式旨在加速人工智能驱动的诊断工具的部署，重点关注高通量传染病和肿瘤检测，在这些领域，软硬件同步对于检测精度至关重要。

- **医疗保健公司推出人工智能驱动的 LOGIQ 超声系统，用于自动化临床工作流程**

GE 医疗推出了新一代 LOGIQ 超声系统，该系统采用 Verisound 数字技术和先进的人工智能技术。这一代产品（包括 E10 和 Fortis 型号）的研发重点在于实现临床工作流程的自动化，并提高肝脏疾病的诊断准确性。通过利用人工智能技术实现解剖结构识别和数据测量的自动化，GE 医疗正在将超声终端从简单的成像工具转变为智能诊断助手，从而减轻超声医师的认知负担。

- **飞利浦首席执行官强调“环境感知”是未来医疗研发的核心支柱**

在 2026 年印度人工智能峰会上，飞利浦首席执行官罗伊·雅各布斯强调，医疗设备的研发已从可选升级转变为基础必需。飞利浦正将其全球研发重心转向“环境感知”，这一战略利用人工智能监测和解读整个临床环境（包括语音、行为和生理数据），而不仅仅是患者的生命体征。此举旨在通过非侵入式传感器实现临床文档管理的自动化和患者监测，从而利用人工智能作为桥梁，更好地管理有限的医疗资源。

- **美敦力通过 Hugo 系统商业化和 PFA 创新扩大机器人手术业务版图**

美敦力公司的 Hugo 机器人辅助手术系统已在美国克利夫兰诊所成功完成首批商业临床试验。继此里程碑之后，该公司宣布大幅增加 2026 年的研发预算，重点开发用于脉冲场消融术（PFA）的智能控制系统。此次研发方向的转变旨在将更高水平的自主安全功能集成到机器人平台中，确保在复杂的心脏和泌尿外科手术中实现精准的能量输送和主动风险控制。

四、重点产品行情

(一) 存储芯片

2026 年 2 月存储芯片重点产品行情一览

产品	价格趋势	交期（周）	供需状态
DDR3、DDR4	上涨	12-30	紧张
DDR5	上涨	12-40	紧张
HBM	上涨	12-30	紧张
NAND Flash	上涨	12-30	紧张

信息来源：TrendForce

● 存储芯片产能告急，卖方市场格局已然确立。

1) 产品动态

- **DDR3/DDR4:** 原厂持续将产能转移至高阶与先进制程，导致 DDR4 与 DDR3 等旧世代规格供给缺口仍在，为价格提供有力支撑。DDR4 8Gb 颗粒从 2025 年 3 月的 1.3 美元，一路飙升至 2026 年 2 月的 13 美元，累计涨幅接近 10 倍。
- **DDR5:**三星、SK 海力士两大 DRAM 巨头已向客户正式通知，第二季度继续大幅上调 DRAM 价格，部分产品涨幅高达 100%，DDR5 颗粒统一涨价 40%，中小客户甚至需接受两倍以上涨幅才能拿到货源。
- **NAND Flash:** 因原厂更看好 DRAM 市场获利前景，积极将部分产线转为生产 DRAM，进一步压缩 NAND Flash 新增产能，短期内产能瓶颈难以舒缓。Kioxia/SanDisk 货源极少，价格已高于 SAMSUNG，且市场传其 2026 年或减产一半；Winbond 上调 20%—30%并间歇性封盘。

2) 市场趋势

- **存储芯片供应缺口加剧，卖方市场确立:** 全新的“结算后定价”模式兴起，最终定价将在交货后按市场行情进行调整，全部风险降转移至采购方。SK 海力士表示，

当前 DRAM 及 NAND 整体库存仅够维持约 4 周，处于历史极低水平，所有客户均无法获得足额供应，价格持续上涨已成定局。

- **价格走势与市场预测：**从价格走势看，DRAM 已开启“疯涨模式”。台媒预测，32GB DDR5 内存将从约 1 万新台币暴涨至 2 万新台币，价格直接翻倍。Gartner 更预测，到 2026 年底，DRAM、SSD 价格将较上年上涨 130%，涨价潮将贯穿全年。
- **结构性失衡与市场格局：**与以往周期不同，本轮涨价并非短期波动，而是结构性供需失衡。全球 DRAM 市场由三星、SK 海力士、美光三巨头垄断，合计份额超 90%。2026 年三大厂商产能仅小幅增长约 7%，远跟不上 AI 驱动的需求爆发，供给刚性极强，涨价几乎没有阻力。

(二) CPU

2026 年 2 月 CPU 重点产品行情一览

产品	代表型号	厂商	价格趋势	供需状态
消费级	RTX 5090	英伟达 Nvidia	上涨	紧缺
数据中心	Genoa 系列	超威半导体 AMD	-	紧缺
	Turin 系列	超威半导体 AMD	-	紧缺

数据来源：金融界、CFM 闪存市场

- **AI 算力需求爆发，带动 CPU 市场需求增长。**

1) 产品动态

- **服务器 CPU 市场出现严重供不应求：**英特尔与 AMD 产能已基本售罄，并计划将价格上调 10%-15%。AMD 近期斩获 Meta 千亿级 AI 芯片大单，为其部署高达 6 吉瓦算力，成为 AI 基础设施领域的关键突破。与此同时，消费级桌面 CPU 双双跳票，原定 2026 年发布的 AMD Zen 6 与 Intel Nova Lake 系列均延后至 2027 年

CES。

2) 市场趋势

- **CPU 市场将呈现分化格局：**万创投行副总裁代智勇认为，消费级 CPU 价格整体稳定，服务器端虽面临波动，但随着产能释放和系统优化，出现全面持续大涨的可能性较低；长期看，CPU 角色正从单一算力提供者转向系统调度中枢，未来值得关注的方向包括面向 AI 服务器的高并发低延迟产品、异构计算架构，以及特定场景下的稳定供给方案。

(三) 存储设备

2026 年 2 月各厂商存储设备交期情况

厂商	产品	交期（周）	交期趋势
西部数据公司 WD	大容量 HDD	12 周以上	交期延长
希捷 Seagate	大容量 HDD	40 周以上	交期延长
金士顿 Kingston	内存条	6-12	交期延长
	内存卡	6-12	交期延长
	SSD	24-26	交期延长
	eMMC	24-26	交期延长
威刚 ADATA	内存条	26-52	交期延长
	内存卡	26-52	交期延长
	SSD	26-52	交期延长
	eMMC	26-52	交期延长

数据来源：富昌电子、搜狐号

- **存储设备全面涨价严重缺货，消费市场供应受压**

1) 产品动态

- **eMMC:**中国台湾地区 Phison 首席执行官潘健成称，一款广泛用于百元级设备的

8GB eMMC 嵌入式存储组件，价格从 2025 年初的 1.32 美元飙升至近期的 17.60 美元，涨幅超 12 倍。

- **SSD：**SSD 闪存端，128Gb MLC 颗粒 2 月均价 12.67 美元，连涨 14 个月，环比涨幅 33.91%，TrendForce 预计下半年供需仍失衡，价格未见顶点。
- **HDD：**HDD 厂商希捷，西部数据宣布 2026 年 HDD 全年产能已基本售罄，其中只有 5% 属于消费类市场，这意味着 26 年 HDD 在普通消费市场将面临严重短缺。

2) 市场趋势

- **消费级存储设备持续紧缺：**西部数据 2 月财报显示，其 2026 年 HDD 产能已被企业客户预订一空，并签定覆盖至 2028 年的长期协议。目前云业务收入占总营收 89%，消费级仅占 5%。这意味着在 AI 浪潮下，HDD 厂商已倒向企业市场，普通消费者未来将面临可选型号少、到货周期长的困境。
- **成本压力引发终端涨价潮：**存储设备成本的飙升已深刻传导至下游终端市场。Gartner 在 2 月底的报告中指出，存储设备在 PC 整机成本中的占比已从去年的 16% 激增至目前的最高 23%。这一成本压力已演变为全行业的涨价潮。

信息来源

- [1] Agence France-Presse. "Intel suspends expansion of factory plan in Israel." New Age BD, February 12, 2026.
- [2] AMD. "AMD and Meta Announce Strategic AI Collaboration." AMD Newsroom, Feb 24, 2026.
- [3] Analog Devices. "Analog Devices Reports Q1 Fiscal 2026 Financial Results." Analog Devices Investor Relations, Feb 18, 2026.
- [4] Broadcom. "Broadcom Introduces Industry's First 6G-Ready DFE Chip." Broadcom Newsroom, Feb 19, 2026.
- [5] Counterpoint Research. "Custom AI Chip Market Forecast 2026." Counterpoint Research, Feb 4, 2026.
- [6] Deutsche Bank Research. "Research note on 10-year Treasury yield sensitivity to oil prices." Deutsche Bank, February 2026.
- [7] European Commission. "EU Chips Act pilot line NanoIC launch announcement." European Commission, February 9, 2026.
- [8] Federal Reserve. "Federal Open Market Committee Meeting Minutes, January 2026." Federal Reserve, February 2026.
- [9] Government of Ireland. "National Semiconductor Competency Centre launch announcement." Government of Ireland, February 17, 2026.
- [10] Intel Corporation. "Intel Q4 2025 Earnings Report." Intel Investor Relations, Feb 5, 2026.
- [11] Intel Corporation. "Unified Core Design Team Job Posting." Intel Careers, Feb 20, 2026.
- [12] Investing.com. "U.S. 10-Year Treasury Bond Yield Historical Data." Investing.com, accessed February 2026.
- [13] Infineon Technologies. "Infineon to Adjust Prices for Selected Power Semiconductor Products from April 2026." Infineon Newsroom, Feb 10, 2026.
- [14] Infineon Technologies. "Infineon Completes Acquisition of ams OSRAM's Non-Optical Sensor Business." Infineon Newsroom, Feb 25, 2026.
- [15] J.P. Morgan & S&P Global Market Intelligence. "J.P. Morgan Global Manufacturing PMI® – January 2026." J.P. Morgan, February 2026.
- [16] KIOXIA. "KIOXIA Samples UFS 5.0 Embedded Flash Memory." KIOXIA

Newsroom, Feb 24, 2026.

[17] Korea Customs Service. "Semiconductor Export Data, January 2026." Korea Customs Service, February 2026.

[18] Korean Ministry of Trade, Industry and Energy. "National Foundry Construction Plan and SME Support Program." Ministry of Trade, Industry and Energy, February 11, 2026.

[19] Microchip Technology. "Microchip Technology Announces Financial Results for Third Quarter of Fiscal Year 2026." Microchip Investor Relations, Feb 5, 2026.

[20] Micron Technology. "Micron Announces \$200 Billion U.S. Expansion Plan to Address AI-Driven Memory Demand." Micron Newsroom, Feb 16, 2026.

[21] Morgan Stanley. "KIOXIA Pricing Strategy and Margin Outlook." Morgan Stanley Research, Feb 18, 2026.

[22] NVIDIA. "NVIDIA Announces Financial Results for Fourth Quarter and Fiscal 2026." NVIDIA Investor Relations, Feb 25, 2026.

[23] NXP Semiconductors. "NXP Completes Sale of MEMS Sensors Business to STMicroelectronics." NXP Newsroom, Feb 10, 2026.

[24] NXP Semiconductors. "NXP Introduces Industry's First 10BASE-T1S PMD Transceiver." NXP Newsroom, Feb 22, 2026.

[25] Ondernemingskamer. "Beschikking inzake Nexperia B.V." Gerechtshof Amsterdam, Feb 12, 2026.

[26] Renesas. "GlobalFoundries and Renesas Expand Partnership to Accelerate Semiconductor Manufacturing." Renesas Newsroom, Feb 16, 2026.

[27] Renesas. "Renesas' R-Car V4H SoC Adopted in Toyota's New RAV4." Renesas Newsroom, Feb 24, 2026.

[28] Reuters. "Reports on Japanese government subsidy proposals to Samsung and SK Hynix." Reuters, February 2026.

[29] Samsung Electronics. "Five-Year Investment Plan in South Korea announcement." Samsung Electronics, February 2026.

[30] Semiconductor Industry Association (SIA). "Global Annual Semiconductor Sales Increase 25.6% to \$791.7 Billion in 2025." SIA, February 6, 2026.

- [31] SK Hynix. "Official response regarding Japan fab investment rumors." SK Hynix, February 2026.
- [32] SK hynix. "SK hynix and SanDisk Launch HBF Standardization Initiative." SK hynix Newsroom, Feb 25, 2026.
- [33] SK hynix. "SK hynix Board Approves Additional Investment for Yongin Semiconductor Cluster." SK hynix Newsroom, Feb 25, 2026.
- [34] SK hynix. "SK hynix Accelerates Transition to AI Memory Customization with Yongin Investment." SK hynix Investor Relations, Feb 26, 2026.
- [35] STMicroelectronics. "STMicroelectronics and AWS Announce Multi-Billion Dollar Strategic Collaboration." ST Newsroom, Feb 9, 2026.
- [36] STMicroelectronics. "ST Introduces World's First Automotive MCU with Integrated AI Accelerator." ST Newsroom, Feb 10, 2026.
- [37] Texas Instruments. "Texas Instruments to Acquire Silicon Labs." TI Newsroom, Feb 4, 2026.
- [38] Texas Instruments. "TI Capital Management Update 2026." TI Investor Relations, Feb 25, 2026.
- [39] The Economic Times. "Iran conflict threatens India's \$4.5 billion electronics exports to Gulf via UAE, Hormuz route disruptions." The Economic Times, March 2, 2026.
- [40] The Guardian. "Meta agrees \$60bn deal with chipmaker AMD despite AI bubble fears." The Guardian, Feb 26, 2026.
- [41] The Motley Fool. "Analog Devices (ADI) Q1 2026 Earnings Call Transcript." The Motley Fool, Feb 18, 2026.
- [42] The Motley Fool. "Microchip (MCHP) Q3 2026 Earnings Call Transcript." The Motley Fool, Feb 5, 2026.
- [43] The Wall Street Journal. "Micron Plans \$200 Billion Investment in U.S. Memory Chip Production." The Wall Street Journal, Feb 16, 2026.
- [44] TrendForce. "Q4 2025 DRAM Industry Revenue Ranking." TrendForce, Feb 26, 2026.
- [45] TrendForce. "TSMC Speeds up Expansion in Taiwan: up to 10 Fabs Reportedly under Construction or Starting in 2026." TrendForce, Feb 23, 2026.
- [46] U.S. Supreme Court. "Ruling on Trump administration tariff policy

under the International Emergency Economic Powers Act.” U.S. Supreme Court, February 20, 2026.

[47] U.S. White House. “Executive Order on Implementing New Global Baseline Tariffs.” The White House, February 2026.

[48] Wind. “Historical Manufacturing PMI Data for Global and Major Economies.” Wind, February 2026.

[49] Wolfe Research. “Wolfe Research Semiconductor Conference Transcript.” Wolfe Research, Feb 11, 2026.

[50] 新华社. “霍尔木兹海峡油轮运输陷入停滞.” 人民网, 2026 年 2 月 28 日.

[51] 中化新网. “卡塔尔能源、液化空气签署长期供氦协议.” 新浪财经, 2026 年 2 月 4 日.

[52] 上海彭博财经资讯有限公司. “马士基暂停苏伊士运河与曼德海峡航线，全球航运再受冲击.” 博易大师, 2026 年 3 月 2 日.

[53] 士兰微. “关于调整部分产品价格的通知.” 士兰微电子官方网站, Feb 20, 2026.

[54] 新洁能. “MOSFET 产品价格调整通知函.” 新洁能投资者关系, Feb 25, 2026.

[55] 宏微科技. “关于 IGBT 及 MOSFET 等核心器件价格调整的通知.” 宏微科技官方网站, Feb 24, 2026.

[56] 华润微. “全系列微电子产品价格调整通知.” 华润微投资者关系, Jan 28, 2026.

[57] 财联社. “英伟达财报会实录 | 黄仁勋扫清市场忧虑: AI 新时代 算力即营收!” 财联社, Feb 26, 2026.

[58] 韩国国会. “关于加强半导体产业竞争力和扶持力度的特别法.” 韩国国会, 2026 年 2 月.

[59] 华邦电子. “2025 年第四季法人说明会.” 华邦电子投资人关系, Feb 20, 2026.

[60] 快科技. “台积电产能扩张提速: 有望同步推进十座晶圆厂.” 快科技, Feb 24, 2026.

[61] 力积电. “力积电与美光科技签署战略合作协议.” 力积电投资人关系, Feb 10, 2026.

[62] 联合新闻网. “中国台湾新增 18 项高科技出口管制相关报道.” 联合新闻网, 2026 年 2 月.

[63] 每经 AI 快讯. “美国国债收益率最新数据.” 每日经济新闻, 2026 年 2 月 26 日.

- [64] 南亞科技. “2026 年 1 月營收報告.” 南亞科技投資人關係, Feb 4, 2026.
- [65] 格隆汇. “美国国债收益率纽约尾盘数据.” 格隆汇, 2026 年 2 月 25 日.
- [66] 深圳市工业和信息化局. “深圳市 ‘人工智能+’ 先进制造业行动计划 (2026-2027 年).” 深圳市工业和信息化局, 2026 年 2 月.
- [67] 新浪财经. “英伟达最新季度营收创新高, 黄仁勋称 AI 已到拐点.” 新浪财经, Feb 26, 2026.
- [68] 芯闻前沿. “中国台湾力积电联手美光科技重塑 DRAM 产业链格局.” 芯闻前沿, Feb 12, 2026.
- [69] 中华人民共和国商务部. “出口管制管控名单公告 (2026 年 2 月 24 日).” 中华人民共和国商务部, 2026 年 2 月 24 日.
- [70] 中华人民共和国商务部. “关注名单公告 (2026 年 2 月 24 日).” 中华人民共和国商务部, 2026 年 2 月 24 日.
- [71] 中华人民共和国外交部. “2026 年 2 月 12 日外交部发言人林剑主持例行记者会.” 外交部网站, Feb 12, 2026.
- [72] 中時新聞網. “辉达开奖 台积电衝上 2000 元大关.” 中時新聞網, Feb 26, 2026.
- [73] 中国台湾地区经济部国际贸易署. “战略性高科技货品种类、特定战略性高科技货品种类及输出管制地区修正公告.” 经济部国际贸易署, 2026 年 2 月 11 日.
- [74] 财联社. “SK 海力士拟在韩国投资 150 亿美元 以扩建芯片产能.” 财联社, Feb 25, 2026.
- [75] 新浪财经. “SK 海力士向龙仁工厂追投千亿.” 新浪财经, Feb 26, 2026.
- [76] Investing.com. “猛砸 150 億美元! SK 海力士瘋狂建廠, 股價漲瘋了.” Investing.com, Feb 27, 2026.
- [77] CFM 闪存市场. “SK 海力士龙仁工厂洁净室拟提前启用, 扩产进度加速.” CFM 闪存市场, Feb 26, 2026.
- [78] TechAfrica News. 《亚马逊与 OpenAI 宣布多年战略合作伙伴关系, 加速企业级人工智能发展》2026 年 2 月 27 日.
- [79] TechPowerUp. 《AMD 与 Meta 宣布扩大战略合作, 部署 6 吉瓦 AMD GPU》2026 年 2 月 24 日.
- [80] Finviz. 《人工智能支出带来的资本开支压力上升, MSFT 股票是否面临风险? 》2026 年 2 月 23 日.
- [81] TechAfrica News. 《TrendForce 称全球云服务提供商 (CSP) 将在 2026 年

投入 7100 亿美元用于 AI 服务器》2026 年 2 月 26 日。

[82] ATGBICS.《谷歌 2026 年 AI 投资: Alphabet 将在数据中心和云基础设施上投入高达 1850 亿美元》2026 年 2 月 26 日。

[83] Wccfttech.《华为号称可与 NVIDIA Vera Rubin 竞争的产品将在 MWC 首次公开亮相》2026 年 2 月 24 日。

[84] Reuters.《CoreWeave 因资本支出翻倍引发利润率担忧, 股价下跌》2026 年 2 月 27 日。

[85] Pandaily.《寒武纪自上市以来首次实现全年盈利, 2025 年营收激增 453%》2026 年 2 月 27 日。

[86] Robozaps.《特斯拉 Optimus 第二代评测 (2026) : 真实工厂表现及第三代时间表》2026 年 2 月。

[87] Argus Media.《美国特斯拉推进人形机器人生产; 第三代计划于 2026 年初发布》2026 年 2 月 2 日。

[88] Asia News Network.《春晚演出后中国制造人形机器人订单激增; 宇树 G1 领跑需求》2026 年 2 月 28 日。

[89] Agibot Official.《Agibot 与敏实集团在德国发布完整机器人产品组合; 达成汽车领域部署战略合作》2026 年 2 月 24 日。

[90] GlobeNewswire.《Agibot 通过在樟宜机场的部署型项目加速新加坡市场布局》2026 年 2 月 23 日。

[91] Humanoids Daily.《AgiBot Expedition A2 完成 106 公里徒步, 刷新人形机器人耐力纪录》2026 年 2 月。

[92] GlobalChinaEV.《比亚迪将于 3 月 5 日发布重磅技术: DiPilot 5.0 及第二代刀片电池》2026 年 2 月 23 日。

[93] Car and Driver.《特斯拉将全自动驾驶系统改为每月 99 美元的纯订阅模式》Car and Driver Technology, 2026 年 2 月 14 日。

[94] CnEVPost.《小米汽车将 2026 年交付目标上调至 55 万辆, 并在慕尼黑设立研发中心》CnEVPost Global, 2026 年 2 月 13 日。

[95] 理想汽车投资者关系.《理想汽车 2026 年 2 月交付更新及 OTA 8.3 VLA 模型发布》理想汽车 IR 新闻稿, 2026 年 3 月 1 日。

[96] 小鹏汽车投资者关系.《小鹏发布第二代 VLA 模型及图灵 AI 芯片适配战略》小鹏 IR 新闻, 2026 年 3 月 2 日。

[97] MarketScreener.《瑞萨电子通过强化领导层推进印度与中国战略》2026 年 3

月 1 日。

[98] Tech in Asia. 《苹果将 Mac Mini 生产从亚洲迁至休斯敦；富士康投资 4.5 亿美元建设新 AI 服务器工厂》Tech in Asia, 2026 年 2 月 24 日。

[99] Siemens Newsroom. 《西门子推出 Questa One——业内首个用于功能验证的代理式 AI 工具包》2026 年 2 月 27 日。

[100] AKM News. 《中国迈瑞医疗计划配售价值 10 亿美元股份，用于全球研发与扩张》AKM.ru, 2026 年 2 月 28 日。

[101] Pharmafile. 《西门子医疗在爱尔兰斯沃兹开设价值 1000 万欧元的实验室设备研发中心》Pharmafile, 2026 年 2 月 19 日。

[102] Zacks. 《GE 医疗推出新一代 AI LOGIQ 超声系统，提升影像工作流程效率》Zacks 投资研究, 2026 年 2 月 26 日。

[103] Philips News. 《飞利浦首席执行官 Roy Jakobs 在印度 AI 峰会上表示：专注环境感知技术以弥合医疗差距》Philips Global, 2026 年 2 月 20 日。

[104] Medtronic. 《美敦力 2026 财年第三季度财报：Hugo 机器人系统扩张及 PFA 研发增长》美敦力投资者关系, 2026 年 2 月 17 日。

[105] 芯通社, 三星海力士通知客户再涨 100%, 2026.03.02

[106] 华尔街见闻, 高盛重磅报告：十五年来最严重的存储芯片短缺正在逼近, 2026.02.09

[107] 芯研究, 彻底赚翻了！DRAM 价格暴涨 180%，NAND 闪存大涨 120%, 2026.02.10

[108] 满天芯, 库存仅剩 4 周！SK 海力士：所有客户需求都无法满足, 2026.02.25

[109] 证券日报, 内存价格持续大涨 存储产业链格局生变, 2026.02.11

[110] 芯智讯, TrendForce 发布最新存储产业调查报告 涨价持续, 2026.02.03

[111] 财联社, AI 带热 CPU 销情？记者实探深圳华强北：涨价潮尚未蔓延至 C 端，业内预期分化|传真, 2026.02.03

[112] 太平洋科技, PC 圈重磅变局！Intel、AMD 新一代桌面 CPU 双双跳票 2027, 2026.02.25

[113] 证券时报, 深夜拉升！芯片巨头大涨！, 2026.02.24

[114] 东吴证券股份有限公司, 计算机行业点评报告：CPU 涨价 CPU 有望在 AGENT 时代迎来大周期, 2026.02.02

[115] IT 之家, Gartner：本轮存储器“超级周期”将毁灭 < 500 美元入门 PC 市场, 2026.02.15

[116] IT之家，西部数据：2026 年机械硬盘产能已售罄，消费级业务仅占 5%，
2026.02.15

[117] 泰盛国际科技，存储涨价传导下游，DRAM 提价、HBM 争夺，EUV 优化，
美光 GDDR7 助力 RTX50 显卡，2026.03.02

[118] 希捷硬盘知识，硬盘还会继续涨？2026 年采购白皮书：这 3 类人必须立即下手！，
2026.02.27

[119] 搜狐号，西部数据 HDD 产能告急！普通人买硬盘要多花钱了，2026.02.16

[120] 芯通社，三星海力士通知客户再涨 100%，2026.03.02

[121] TrendForce，2026 年 2 月利基型 DRAM 價格，2026.02.26

[122] 半导体芯情，夸张！第二季度原厂继续大幅度上调内存芯片价格，部分涨达
100%，手机厂计划 3 月集体涨价应对，2026.03.02

[123] 快科技，内存价格连涨 11 个月：快要见顶了 SSD 反而要接着涨，2026.02.28

免责声明

安芯易电子商务（深圳）有限公司(下称“安芯易公司”)所发布的月度报告由安芯易公司市场部基于现已公开的资料、信息、研究报告等进行整理编制而成。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映安芯易公司在报告发布当期的判断、观点，仅供学习参考之用，不构成对所述产品的出价、征价、要约或要约邀请，不构成任何合同或承诺的基础，不构成买卖任何投资工具或者达成任何交易的推荐，亦不构成任何投资、采购及其他应用建议和指导，对任何因直接或间接使用本报告涉及的信息和内容或者据此进行交易、投资所造成的一切后果或损失，安芯易公司不承担任何法律责任。因此，读者在阅读本报告时应保持警惕，并进行独立的判断和分析。

安芯易公司对本报告中所引用的资料、研究报告所涉及的或从第三方媒体获得的信息及数据的真实性、准确性、完整性和及时性不作任何明示或默示的保证。所发布的信息、观点以及数据有可能因发布日之后的情势或其他因素的变更而不再准确或失效，但安芯易公司不承担更新不准确或过时的信息、观点以及数据的义务，在对相关信息进行变更或更新时亦不会另行通知。

该报告版权归安芯易公司及相关内容提供方所有，未经授权，任何人不得以任何方式转载、修改、翻版、分发、复制、发表。

安芯易电子商务（深圳）有限公司

2026 年 2 月



安芯易隶属于Ample Solutions集团,成立于2008年,在全球拥有8个办公室,专注于为全球电子制造业客户提供元器件全球采购及供应链服务。我们始终秉持“专注、专业、坚韧、谦卑”的核心价值观,为客户提供卓越服务,助力客户成功。

我们拥有100+资深采购专家,并与来自全球的10000+供应商建立合作,致力于以更快的速度,更低的成本,为客户解决元器件供应链问题。

在深圳和香港,我们建立了两个高标准品质控制中心,严格遵循国际品质控制体系。从供应商管理到品质检测,全方位地防范风险,确保客户的元器件供应链安全和稳定。



洞察行情 精准决策

